

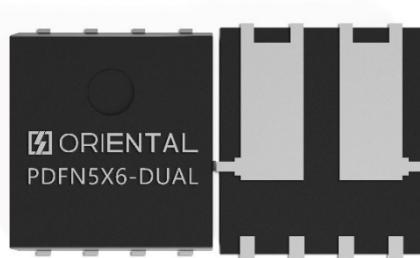


PDFN5X6-DUAL 封装型式

1、封装结构与尺寸：

尺寸：通常为 5.00x6.00mm 或 5.15x6.15mm，与标准 PDFN5X6 封装尺寸一致，但内部集成两颗芯片，实现双通道功能。

散热设计：部分产品采用双面散热技术，通过顶部和底部金属层散热，降低热阻，提升散热效率，适用于高功率密度场景。

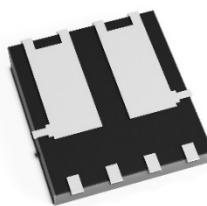


2、应用场景：

汽车电子：常用于新能源汽车的电池管理系统（BMS）、车载充电器（OBC）、DC-DC 转换器等，满足车规级可靠性要求，如符合 AEC-Q101 标准。

工业控制：适用于电机驱动、电源管理等对功率密度和散热要求较高的领域。

消费电子：部分产品用于快充芯片、电源适配器等，兼顾小型化与高效散热需求。



3、技术优势：



-
- 高集成度：双芯片设计减少外部电路连接，简化 PCB 布局，降低系统成本。
 - 低热阻：双面散热或优化的散热结构，有效降低芯片工作温度，提升稳定性。
 - 高可靠性：符合车规级标准，适应高温、高湿、高振动等恶劣环境。

